



ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島成立之有限公司)

二零零二年度經審核業績公佈 截至二零零二年十二月三十一日止年度

二零零二年 ASM 傑出成就

- 於裝嵌及包裝設備業達至全球第一位
- 營業額增加18.3%，其他具領導性競爭者均下滑
- 盈利增長23.1%，其他主要對手均虧損

ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 董事會欣悅地宣佈二零零二年全年業績如下：

業績

謹此欣然報告，ASM Pacific Technology Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASM」）於截至二零零二年十二月三十一日止年度錄得營業額為港幣1,846,016,000元，與上年度港幣1,560,227,000元比較，上升百分之十八點三。在扣除因引線框架電鍍工序由香港遷往中國而導致的一次性重組成本港幣二千萬元後，本年度集團的綜合除稅後淨溢利為港幣284,704,000元，較上年度淨溢利港幣231,246,000元增加百分之二十三點一。是年度每股基本溢利為港幣0.75元（二零零一年：港幣0.61元）。

派息

中期股息每股港幣0.36元（二零零一年：港幣0.36元）已於二零零二年八月派發。在過去數年，集團在微電子市場已建立穩固的基礎，未來將致力透過多元化及高性能的產品擴大市場佔有率，積極加快本體增長。集團在短期沒有重大現金開支，並於過往數年維持正現金流量。在擁有充裕的流動資金和股本增加的情況下，董事會現建議派發末期股息每股港幣0.64元（二零零一年：港幣0.64元），於二零零三年四月二十八日左右派發。截至二零零二年十二月三十一日止年度全年合計每股派息為港幣1.00元（二零零一年：港幣1.00元）。於二零零零年至二零零二年間，派息率為百分之七十五點二，充份顯示集團決定將剩餘現金回饋予股東時已作審慎考慮，並預留適量的股本作集團營運之用。

財務概要

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零二年	二零零一年
	港幣千元	港幣千元
營業額	1,846,016	1,560,227
銷貨成本	(1,072,294)	(930,038)
毛利	773,722	630,189
其他收益	7,403	28,156
銷售費用	(175,065)	(138,720)
一般管理費用	(96,731)	(103,944)
研究及發展淨支出	(186,980)	(166,400)
廠房遷移開支	(20,000)	—
經營溢利	302,349	249,281
財務費用	(168)	(155)
除稅前溢利	302,181	249,126
稅項	(17,477)	(17,880)
本年度淨溢利	284,704	231,246
股息	382,696	380,926
每股溢利		
— 基本	港幣0.75元	港幣0.61元
— 攤薄	港幣0.74元	港幣0.61元

附註：

1. 分類資料

分類營業額及業績

業務分類

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
收益		
設備	1,459,107	1,241,926
引線框架	386,909	318,301
	<u>1,846,016</u>	<u>1,560,227</u>
業績		
設備	278,018	224,082
引線框架(備註)	17,811	2,987
	<u>295,829</u>	<u>227,069</u>
未分配之集團收入	6,520	22,212
	<u>302,349</u>	<u>249,281</u>
業務溢利	302,349	249,281
財務費用	(168)	(155)
	<u>302,181</u>	<u>249,126</u>
除稅前溢利	302,181	249,126
稅項	(17,477)	(17,880)
	<u>284,704</u>	<u>231,246</u>

備註：二零零二年業績已扣除廠房遷移開支港幣二千萬元。(見附註第四項)

地區分類

	營業額		業務溢利	
	截至十二月三十一日止年度		截至十二月三十一日止年度	
	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
a. 業務地區				
中華人民共和國 (「中國」)	1,170,263	1,036,803	222,803	186,859
新加坡及 馬來西亞	675,753	523,424	73,026	40,210
	<u>1,846,016</u>	<u>1,560,227</u>	<u>295,829</u>	<u>227,069</u>
未分配之 集團收入			6,520	22,212
業務溢利			<u>302,349</u>	<u>249,281</u>
			營業額	
			截至十二月三十一日止年度	
			二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
b. 市場地區				
台灣			433,557	260,120
中國大陸			274,826	206,116
馬來西亞			228,090	232,727
韓國			168,100	79,395
新加坡			138,085	157,529
香港			134,316	117,745
美國			115,476	58,018
泰國			108,530	106,455
菲律賓			98,951	140,076
日本			68,799	96,934
歐洲			42,167	79,592
其他			35,119	25,520
			<u>1,846,016</u>	<u>1,560,227</u>

地域分區市場對溢利貢獻未有呈報，因每一地域分區之溢利貢獻與集團之溢利營業額比率大致相符。

2. 折舊

於本年內，集團的物業、廠房及設備之折舊為港幣一億五千六百四十萬元(二零零一年：港幣一億五千一百八十萬元)。

3. 稅項

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零二年	二零零一年
	港幣千元	港幣千元
稅項包括：		
香港：		
按本年度估計應課稅溢利以稅率		
16%計算之利得稅	23,734	15,220
往年備撥過多	(1,548)	(380)
	<u>22,186</u>	<u>14,840</u>
其他司法權區之稅項	1,961	4,251
	<u>24,147</u>	<u>19,091</u>
遞延稅項抵免	(6,670)	(1,211)
	<u>17,477</u>	<u>17,880</u>

其他司法權區之稅項乃根據有關司法權區包括中國除香港外之其他地區及海外之現行稅率計算。

集團新加坡分部獲當地政府頒發「生產總部」榮譽，根據新加坡稅務當局授與之稅務獎勵計劃，本集團在新加坡生產之若干半導體設備及物料新產品所產生之溢利毋須課稅，自二零零一年一月一日起十年內，在新加坡分部履行若干條件下，該等優惠將為有效。

遞延稅項就董事會於考慮中期財務計畫及預測後，認為在可見將來會出現之時間差距而進行備撥。

本年度的遞延稅務(抵免)支出款額如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零二年	二零零一年
	港幣千元	港幣千元
時間差距之稅務影響來自：		
稅項折舊與計入財務報表之		
折舊費用差距之數額	(3,914)	(2,040)
稅務虧損	(2,971)	(1,164)
其他時間差距	215	1,993
	<u>(6,670)</u>	<u>(1,211)</u>

4. 廠房遷移開支

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零二年	二零零一年
	港幣千元	港幣千元
費用包括：		
預提員工離職費	15,000	—
物業、廠房及設備之減值	4,488	—
廠房搬遷及關閉費用	512	—
	<u>20,000</u>	<u>—</u>

集團其中一個廠房由香港遷往中國大陸之遷移開支。

5. 每股溢利

每股基本及攤薄溢利乃根據下列數據計算：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零二年	二零零一年
	港幣千元	港幣千元
計算每股基本及攤薄溢利之股東應佔溢利	<u>284,704</u>	<u>231,246</u>
	股份之數量(以千位計)	
計算每股基本溢利之加權平均股數	381,650	379,868
來自僱員股份獎勵制度之潛在攤薄影響	<u>1,528</u>	<u>1,509</u>
計算每股攤薄溢利之加權平均股數	<u>383,178</u>	<u>381,377</u>

業務回顧

在這一年，當其他著名裝嵌及包裝設備競爭對手均錄得虧損及收益下降，ASM 再度超越同儕，取代行業領導者於裝嵌及包裝設備業達至全球第一位，營業額增加百分之十八點三，達二億三千六百七十萬美元(二零零一年：二億美元)。資本回報率及銷售利潤率分別為百分之十七點一和百分之十六，縱然面對艱難的市場情況，仍與過去數年的表現相若。

有此成績主要由於集團多年來透過產品及應用市場多元化、有效的成本結構及成功推出新產品以擴大市場佔有率，成功建立起穩固的基礎。於二零零二年，我們五大客戶共佔集團營業額少於百分之二十五，並沒有單一客戶的銷售額佔超過百分之十。這足以證明我們的市場多元化策略是成功的。

電子供應鏈過剩的存貨已於二零零一年被大量消化，使得二零零二年半導體業的產量開始反映真正的最終產品需求。在全球經濟疲弱、戰爭如箭在弦、環球股市表現欠佳，以及電子貨品降價的陰影下，產品需求及投資氣氛並未有如預期中受到刺激。縱使某些半導體公司所公佈的銷售量已回復至其以往高峰時期的水平，及行業分析機構 InStat 預測行業銷售量將有百分之十八的增長，但大部份的半導體行業研究機構 (Dataquest, IC Insights, iSuppli, WSTS, SIA, VLSI Research) 均總結認為由於平均售價受壓，二零零二年的收益只有百分之一至二的增長。

相應這緩慢的增長，半導體裝嵌設備行業亦走出谷底，並於二零零二年首季末開始復甦。然而，第二季設備訂單的強勁動力並未能於其後持續，訂單在年內往後的季度內持續疲弱。客戶在增加產能時顯得格外審慎，且留待需求獲得確定後才落實。大部份的集成電路包裝設備訂單均屬於技術提升類別，例如微距焊線及新包裝類別，如 QFN。

繼二零零一年下降百分之七十後，我們所有的具領導性的設備競爭對手在二零零二年的收益均進一步下調。事實上，多個分析機構 (Dataquest, VLSI 及 SEMI) 估計裝嵌及包裝設備市場的下調幅度為百分之九至三十。很多人形容這次的放緩為半導體設備行業歷史中最艱辛及最持久的一次。

正如一九九八年及二零零一年的疲弱時期一樣，是次放緩正好為 ASM 創造寶貴的機會，把我們嶄新及性能超卓的產品推出市場，擴大市場佔有率。我們的設備業務於二零零二年佔集團的營業額百分之七十九，較去年增長百分之十七點五。於二零零二年，我們已超越一直處於行業領導地位的對手，在裝嵌及包裝業內達至全球第一位。同樣突出的是，我們的引線框架銷售於期內上升百分之二十一點六，遠超 SEMI 所預測百分之十點一的市場增長。面對重大的行業波動，ASM 仍能迅速恢復表現，於競爭對手中突圍而出，為未來企業進一步發展鋪路。

正當我們大部份的競爭對手裁減人手、縮減項目規模以盡量降低其現金流出之際，ASM 反而加速技術及產品的開發。去年，我們的研發開支實質增加至港幣186,980,000元 (二零零一年：港幣166,400,000元)，佔設備銷售額的百分之十二點八 (二零零一年：百分之十三點四)。我們於二零零二年年中推出的 Eagle 60 焊線機，可作35 μ m 微距焊線，進一步鞏固 ASM 的領導地位及市場基礎。在過去數月，Eagle 60 已通過現有客戶及新客戶多個基準測試及審定合格，當中包括集成裝置製造商 (IDMs) 和包裝公司 (subcons)，成績令人滿意。部份的實地評估仍在進行當中，而這新型號產品已於去年第四季成功地邁向量產階段。

其他新產品，如高速嶄新的集成電路及獨立管芯焊接機、精密的覆晶焊接機、管芯分類機、距陣測試處理器以及卷軸完成系統 (Tape and reel finishing system) 等已全部進入量產階段。這些新產品強化了我們於管芯焊機及焊線機市場的領導地位，同時擴闊了我們的客戶基礎，覆蓋以往從未涉足的新市場層面。

近年來，我們憑藉內部的引線框架技術為客戶提供包裝方案，並成功開啟了多個設備業務的大門。為加強競爭優勢，我們決定把所有沖壓框架生產工序綜合在面積約二十六萬平方呎的廠房內。該廠房位於福永，距離深圳機場只需五分鐘車程，而由香港過境經高速公路前往亦只需三十分鐘。廠房於二零零三年中竣工。落成後，這綜合廠房將大大縮短生產周期、減少半製品及提升營運效率，同時降低人手及租金開支，並能預留空間作未來擴展之用。廠房鄰近香港，令我們可保留富經驗的管理層及技術人員，以確保順利過渡，並能在建立多年的基礎上繼續發展，更貼近於中國的客戶及提升本地競爭力。整個廠房項目成本為港幣六千萬元。新電鍍線及額外生產設備的開支已包括在二零零二至二零零三年的資本投資計劃內。額外的港幣二千萬元僱員遣散費用及資產撇銷已於二零零二年的業績內反映。

儘管我們需要處理多項產品的過渡，增加半製品以應付更多元化的產品需要及因應客戶要求縮短交貨時間，ASM 近年廣泛應用於全球業務的企業資源計劃(ERP)軟件已證明能有效地簡化我們的物流及存貨管理。於二零零二年，我們已成功把總存貨量減少港幣一億零一百四十萬元，或較十二個月前降低百分之十六點七。綜合存貨減低及營運所帶來的溢利收益，我們於年內產生港幣三億五千八百八十萬元的自由現金流量(Free cash flow)及錄得投入資本收益率(Return on invested capital)達百分之十九點六。

流動資金及財務狀況

於二零零二年十二月三十一日，集團的股東資金輕微下降至港幣1,756,072,000元(二零零一年：港幣1,829,047,000元)。如過去三年一樣，集團並沒有長期借貸，資產負債比率為零。

儘管派發了港幣三億八千一百六十萬元股息，及於十二個月內投入港幣一億零八十萬元作資本性投資，由於集團的存貨減少及擁有充裕的現金流入，於二零零二年十二月三十一日，手頭現金只是微降至港幣465,569,000元(二零零一年：港幣478,487,000元)。事實上，集團所有的資本性投資乃由是年港幣一億五千六百四十萬元的折舊所支付。

除了向銀行貸款五千三百萬日圓以對沖我們的日圓資產面對的匯率波動外，集團並沒有任何銀行借貸。於二零零二年，銀行貸款對股本比率僅為百分之零點二，而流動比率則為三點九六。於年內，集團緊密監察應收賬款，令應收賬款週轉率維持在八十點八天。

集團主要之銷售貨幣單位為美元，因此匯率風險非常低。另一方面，集團主要以美元、港幣、新加坡幣及人民幣支付開銷。有限量的日圓應收賬款足夠應付部份應付予日本供應商賬款及以上的對沖借貸。

人力資源

集團與員工訂立了具競爭力的薪酬制度。除員工薪金外，集團亦為員工提供其他福利，包括退休供款計劃及醫療津貼。此外，視乎集團的業績及個人表現，個別的花紅及紅股可按需要分發予應嘉許員工。整體而言，集團每年會進行一次薪金調整，並致力維持其嚴謹的員工培訓計劃。

於二零零二年十二月三十一日，集團全球共有約五千三百名員工。

展望

儘管全球經濟放緩，電子產品繼續於我們的日常生活中蓬勃增長，尤其於移動通訊及其他無線設備業將持續呈現這趨勢。行業分析機構 (Dataquest, iSuppli, IC Insights, SIA, VLSI Research, SEMI) 目前預測半導體業將於二零零三年增長百分之十二至二十三，並於二零零四年持續達到雙位數字的增長。根據 InStat 之預測，集成電路產量的增幅將逾百分之十，而 SEMI 的數據顯示其他包裝原料如引線框架將有百分之八點二的增長。晶積度包裝如 QFN 因被廣泛應用於無線通訊及手提產品上，預期增長迅速。

繼裝嵌及包裝設備業於過去兩年持續蕭條的情況後，分析員目前預測於二零零三年此行業將可回復增長百分之十五至二十八，而二零零二年的推測為百分之九至三十的負增長。由於我們客戶的業務均屬資本密集型，故一個活躍及具流動性的資本市場對其融資需要尤為重要。目前，投資者對股票市場的信心仍然疲弱，故相信資本性設備市場只能和緩地復甦。大部份人仕預期今年的訂單比率將按季度逐漸改善。ASM 於年初的積存訂單為三千五百萬美元。

目前的股票市場環境及流動資本短缺的情況實質上令 ASM 受惠，皆因這情況對於我們那些產品種類有限、負債比率高企及財務狀況疲弱的競爭對手造成重大的壓力，迫使他們以長線發展為代價換取短線措施壓止現金外流。反觀 ASM 憑藉充裕的人力資源及零負債的財務優勢，進取地投資於設備及產品創新上，透過包裝發展支援，與客戶締結策略夥伴關係，大大加強我們未來的競爭力。集團計劃於二零零三年的資本性投資為港幣一億六千萬美元。

為滿足先進晶片組裝要求的低K電介體 (low k dielectric)，更微細的管線闊度及銅線交接，ASM 積極以內部資源及與客戶和研究機構共同研發金線及銅線焊接工序。集團將於今年內推出一款高產能的金線焊機，以提升我們的領導地位。同樣地，一款以直線馬達技術開發的微距鋁線焊機將於二零零三年面世，這將進一步鞏固 ASM 於軟包裝市場的主導地位。

正如我們於二零零二年年中期報告中所述，我們已研發金及銅釘頭的焊接機以擴寬覆晶裝嵌設備產品的種類，迎合不同程序需要。與此同時，我們亦正提升 AD900覆晶焊接機於提供熱能超聲波焊接的能力。這兩款機器將可於今年上半年作實地測試。以往集團未有參與以軟焊料裝配的電源芯片 (Power device chip attachment with soft solder process) 市場，但現時我們正準備提供一款具成本效益的軟焊料晶片焊機 (Soft solder die bonder) 以滿足客戶需求。此外，有見 QFN 蝕片引線框架不斷上升的產量需求，我們已裝設卷軸至卷軸蝕片設備及電鍍設備，以滿足生產及成本目標。

於過去數年，眾多集成裝置製造商和包裝公司已於中國或宣佈於中國建立廠房。受惠於內地湧現許多成功企業，中國市場已於二零零二年成為 ASM 第二大的銷售領域，佔集團營業額的百分之十五，帶來有史以來的最高收益及貢獻比率。我們憑藉鄰近市場的優勢，完善的銷售網絡，經驗豐富的當地技術人員及於裝嵌和包裝設備業內的超卓地位，ASM 已處於有利位置，定能受惠於中國半導體業快速增長所帶來的商機。

購買，售賣或贖回本公司股份

本公司及其附屬公司並沒有於是年度內購買、售賣或贖回本公司之股份。

在聯交所網頁登載詳細的業績公告

本公司載有根據香港聯合交易所有限公司(聯交所)證券上市規則附錄十六第45(1)至45(3)段所規定的全部資料的業績公告將在適當時間在聯交所網頁登載。

股東大會

本公司股東大會茲定於二零零三年四月二十五日舉行，本公司年報及股東大會通告將寄發予各股東。

承董事會命
董事
林師龐

香港，二零零三年二月十八日

股東週年大會通告

茲通告 ASM Pacific Technology Limited (「本公司」) 謹定於二零零三年四月二十五日星期五下午三時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場，港麗酒店七樓寶宏廳舉行股東週年大會，以商議下列事項：

1. 省覽及接納截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 宣派截至二零零二年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.64元。
3. 選舉董事及授權董事會釐定董事酬金。
4. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

A. 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段之規限下且在不影響本大會通告第5C項決議案之原則下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(按本決議案第(d)段的定義)行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授出或須行使此項權力之建議、協議及購股權及發行可轉換為股份之其他證券；
- (b) 本決議案第(a)段之批准得授權本公司董事在有關期間作出或授出在有關期間結束後或須行使此項權力之建議、協議及購股權及發行可轉換為股份之其他證券；
- (c) 本公司董事根據本決議案第(a)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式配發)之股本面值總額(根據配售新股而配發者除外)，不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額之20%，上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者中較早之日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依據本公司之公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案載列之授權之日。

「配售新股」指於本公司董事訂定之期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時持有該等股份之比例提呈配售股份之建議（惟本公司董事認為必須或適宜時，可就零碎股份或按照任何香港以外地區之法例之任何限制或責任或任何認可管制機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。」

B. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段之規限下一般及無條件批准本公司董事在有關期間行使本公司所有權力，以在適用法例之規限下，購回本公司股本中之已發行股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准在有關期間購回或有條件或無條件購回之本公司股份之面值總額，不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額之10%，上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列三者中較早之日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依據本公司之公司組織章程細則或任何適用法例之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案之日。」

- C. 「動議待載於本大會通告(本決議案為其中一部份)之5A項及5B項決議案獲通過後，將本公司根據上述5B項決議案所述授予董事之授權購回之本公司股本面值總額，加於本公司董事根據載於大會通告(本決議案為其中一部份)之5A項決議案可予配發或同意有條件或無條件配發之股本面值總額內。」

承董事會命
董事
林師龐

香港，二零零三年二月十八日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表，代其出席大會及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其續會舉行時間最少48小時前送達本公司在香港之主要辦事處，地址為香港葵涌工業街16-22號屈臣氏中心12樓，方為有效。

3. 就上述第5項而言，現正尋求股東授出一般授權以批准配發股份。除配發股份予本公司日期為一九九零年三月二十三之僱員股份獎勵計劃(經由本公司股東於一九八九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上批准)之受托人外，董事現時暫無計劃根據該項批准發行任何本公司之新股份。
4. 本公司將於二零零三年四月十五日至二零零三年四月二十五日(首尾兩天包括在內)暫停辦理過戶登記手續。為合符享有擬派之末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零零三年四月十四日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處 Secretaries Limited，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。

請同時參閱本公佈於(信報／香港經濟日報)刊登的內容。